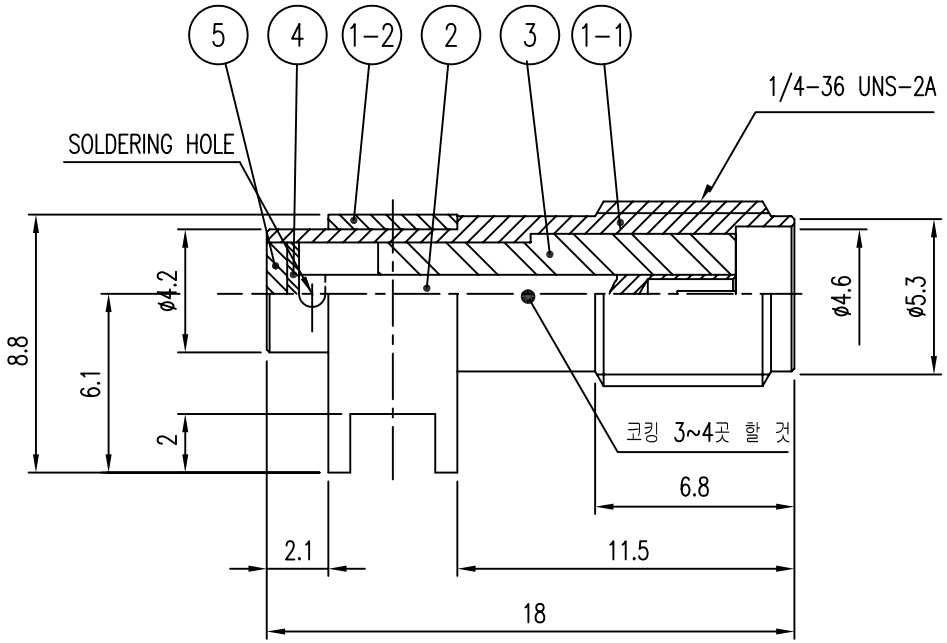
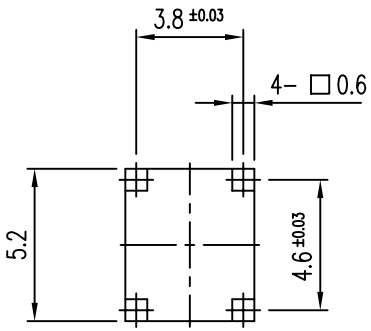
가공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





주 기

1. 도금 방법은 전기도금(유광)으로 할것.
2. SOLDERING HOLE 사각 BODY 뒤에서 우측에 위치 함.

품번		품 명	수량	재 질	표면처리	비 고	
5		COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCO00009-5/1 (L2024)	
4		COVER INSULATOR	1	TEFLON		DIN00921-N/1 (H2183)	
3		INSULATOR	1	TEFLON		DIN00204-N/1 (H2214)	
2		JACK PIN	1	BeCu	Gold Plate	DCT00155-5/1 (E2396)	
1	1-2	사각 BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBB00159-5/1	DBD02055-3/1
	1-1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate		DBD00280-3/1 (D2367A)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2008. 6. 12.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 4/1 단위 mm 중량

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 ANY DATA NET PDA BOARD용 CONN

A4

도번 CN02050-7/1